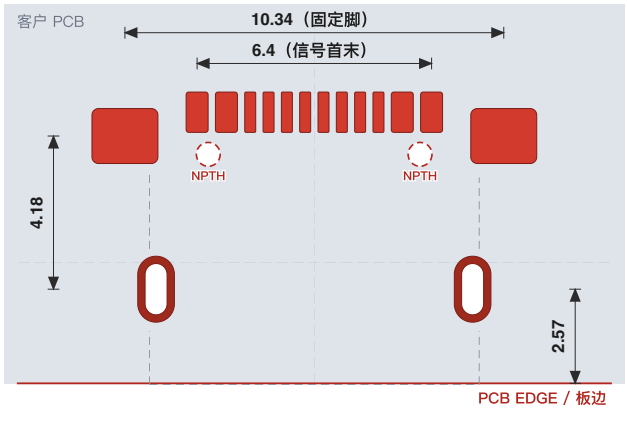
| 料号 PART NO. | 封装 FOOTPRINT | 类型 TYPE |
|---|---|---|
| CF16R-4QS73Z3-163SN10 | CF16R-4QS73Z3-163SN10 | 卧式 / 16P |




1 mm · 俯视 · 单位 mm

灰底 = PCB / 红 = 焊盘 / 白孔 = PTH 金属化槽孔 / 红虚线圈 = NPTH 非金属化孔（不焊锡） / 红线 = 板边 / 灰虚线 = 元件外形（示意）

## 关键尺寸

| 项目 | 数值 (mm) |
|---|---|
| 信号焊盘 12 个 | 8×0.3×1.1<br>4×0.6×1.1 |
| 针距 / 首末距 | 0.5 / 0.65 / 0.8 / 6.4 |
| 固定脚焊盘 4 个 | 2×1.8×1.5<br>2×1.0×1.8 |
| 固定脚 槽孔（金属化） | 2×1.4×0.6 |
| 固定脚间距 | 10.34 × 4.18 |
| 板边 → 前排脚中心 | 2.57 |
| 定位柱孔 | Ø0.65 × 2 |
| 焊盘层 | Top（SMD） |
| 三类孔 | SMD 14 / PTH 2 / NPTH 2 |

## 安装要点

- **端口朝板外**：板边在固定脚外侧，插口正前方（插拔方向）不得有任何板材；板边到前排固定脚中心 2.57 mm；悬出板外的只有端口段，焊脚区须全部落在板面范围内。固定脚是穿孔锚定的 PTH 金属化槽，不是平贴焊盘。
- **4 颗固定脚必须全部焊通**：盘 2×1.8×1.5 2×1.0×1.8、槽孔 2×1.4×0.6，孔壁镀铜、脚穿过后上锡；与外壳同网，漏焊一颗装配端会当可选焊盘跳过。定位柱孔是 NPTH、不焊锡，两者不能互换。
- **三类孔：SMD 贴片焊盘**：仅顶层、无孔，SMT 回流焊；**PTH 金属化槽 / 孔**：孔壁镀铜、可插件焊接导通；**NPTH 非金属化孔**：钻孔打通、无铜，只给塑胶柱避位定位、不焊锡。
  本封装含 **2 个 NPTH 非金属化孔**。**嘉立创 EDA 请用「非金属化孔」图元，不勾多层 / 金属化**、勿做成焊盘孔，否则板厂会按 PTH 镀铜。

## 常见问题

| 你会看到 | 实情 |
|---|---|
| **定位柱孔要电镀 / 上锡吗？嘉立创 EDA 怎么做？** | **不要**。NPTH 钻孔打通、无铜，只给塑胶柱避位定位、不焊锡。**嘉立创 EDA 请用「非金属化孔」图元**，不勾多层 / 金属化、勿做成焊盘孔，否则板厂会按 PTH 镀铜。 |
| **两颗焊盘看着一宽一窄，像画错** | 正常。尺寸按本款 PCB 建议图逐颗给出；以关键尺寸表与交付 PcbLib 为准，不要自行切开。 |
| **灰虚线是丝印吗** | **不是**。灰虚线是**元件外形**示意，用来看这个料占多大板面；封装里真正的丝印（Top Overlay）在固定脚处**断开**，以交付 PcbLib 为准。 |
| **固定脚只焊一侧行吗** | **不行**。固定脚与外壳同网，须全部焊通以保证抗剥离。 |
| **SchLib 放置后要手动指定封装吗** | 要。符号库不预挂封装，请在属性里选 **CF16R-4QS73Z3-163SN10**。 |
| **3D 预览里看不到孔** | 正常。3D 只显示产品本体，孔位与孔径以 2D 封装（PcbLib）与随附 PDF 图纸为准。 |

尺寸取自随附 PDF 图纸的 **RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT** 视图，并逐项与交付件 **CF16R-4QS73Z3-163SN10.PcbLib** 核对：信号盘 8×0.3×1.1 4×0.6×1.1、针距 0.5 / 0.65 / 0.8、首末中心距 6.4、固定脚中心距 10.34×4.18、三类孔 SMD 14 / PTH 2 / NPTH 2。